

浙江平板探测器 苏州圣全科技有限公司

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 浙江平板探测器 苏州圣全科技有限公司 |
| 公司名称 | 苏州圣全自动化设备科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市工业园区亭翔街3号 |
| 联系电话 | 13812633160 13812633160 |

产品详情

无损检测技术，即无损检测，是一种在不破坏被检测物质原有状态和化学性质的情况下，获取与被检测物质质量有关的物理和化学信息的检验方法。

无损检测技术广泛应用于汽车、航空航天、科研、增材制造、智能手机等工业领域。可用于锂电池的SMT焊接、IC封装、IGBT半导体、LED灯条背光i气泡占空比检测BGA芯片检测、压铸件的松焊缺陷检测、电子工业产品内部结构的无损缺陷检测等等。

BGA焊球桥连是指两个或多个BGA焊球粘连在一起形成短路的一种缺陷。这种缺陷是由于BGA焊球融化后流动造成粘连导致的一种缺陷。由于这种缺陷会导致短路是决不允许的一种严重缺陷。

焊球移位是指BGA焊球与PCB焊盘未能完全对准，存在相对位移的一种缺陷。这种缺陷常常不影响电气连接，但对器件焊接的机械性能有影响。实际工作中常常允许焊球相对于焊盘有25%的位移，但是相邻焊球之间的间隙不能减小25%及以上。

随着电子技术的飞速发展，SMT技术越来越普及，芯片的尺寸越来越小，芯片的管脚越来越多，尤其是近几年出现的BGA芯片。由于BGA芯片的引脚不是按照常规设计分布在四周，平板探测器，而是分布在芯片底部，因此传统的人工视觉检测无法判断焊点的质量，必须通过ICT功能测试。但一般来说，如果出现批次误差，是无法及时发现和调整的，人工视觉检测是不准确和重复性高的技术。由此，X射线检测技术越来越广泛地应用于SMT回流焊的质量检测，不仅能对焊点进行定性和定量分析，还能及时发现故障并做出调整。

浙江平板探测器-苏州圣全科技有限公司由苏州圣全科技有限公司提供。苏州圣全科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！